



2026 年 8 月 7 日

各 位

キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」生産能力増強 ～ 2030 年に向けて総額 300 億円の投資を行い、月産 800 万㎡体制で生産能力 1.6 倍へ ～

当社（社長 池信省爾）は、上尾事業所およびマレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）にて製造しているキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」の 2028 年以降の生産能力について、[2025 年 1 月 7 日付リリース「キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」生産体制の増強計画」](#)にて公表しました、2030 年度までに月産 560 万㎡へ増強としていた計画を前倒して実行することにより、2028 年度中に月産 600 万㎡体制とし、さらに追加の投資を行い 2030 年度中に生産能力を月産 800 万㎡まで増強する方針です。なお、投資額は 300 億円程度を想定しております。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した $1.5\mu\text{m}$ ～ $5\mu\text{m}$ の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、主に半導体パッケージ基板や光モジュール、スマートフォン用マザーボード（HDI プリント基板）に使用されております。

半導体パッケージ基板ではデータセンターやメモリー基板用途が増加、また光モジュールは AI サーバーへの採用に伴い大きく需要が増加しており、超高速インフラ用多層基板、超高速通信用フレキシブル基板などの新規用途への採用拡大とともに、今後も需要が伸長していくものと考えております。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■ 「MicroThin™」生産能力 単位：万㎡/月（ご参考）

	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2030 年度
上尾事業所	250	250	260	280	※検討中
マレーシア工場	240	240	260	320	※検討中
計	490	490	520	600	800

※今回、生産能力増強の方針を決定。投資規模、投資場所等については、今後、顧客需要、市場環境、各種支援制度等を踏まえ最終決定。

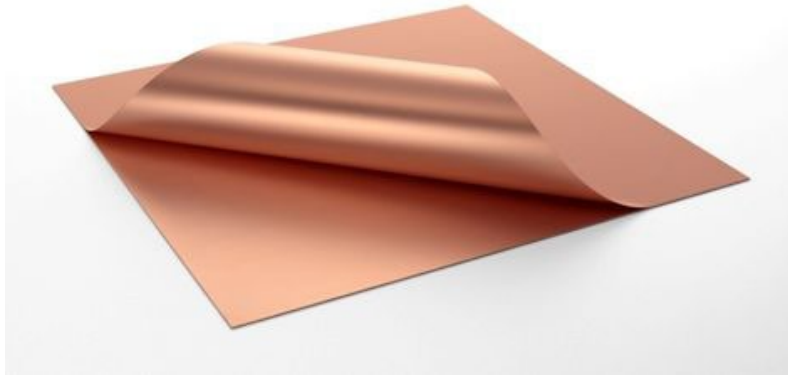
以上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E メール : PR@mitsui-kinzoku.com

「MicroThin™」 写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18 μ m、12 μ m）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5 μ m～5 μ m）